

23680

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
18. August 2005 (18.08.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 2005/076206 A1**

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: **G06K 19/077**

(21) Internationales Aktenzeichen: **PCT/EP2005/000951**

(22) Internationales Anmeldedatum:  
1. Februar 2005 (01.02.2005)

(25) Einreichungssprache: **Deutsch**

(26) Veröffentlichungssprache: **Deutsch**

(30) Angaben zur Priorität:  
10 2004 006 457.1 4. Februar 2004 (04.02.2004) **DE**

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): **BIELOMATIK LEUZE GMBH + CO KG** [DE/DE]; Daimlerstrasse 6-10, 72639 Neuffen (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **BOHN, Martin** [DE/DE]; Lüftestrasse 48, 72762 Reutlingen (DE).

(74) Anwalt: **PATENTANWÄLTE RUFF, WILHELM, BEIER, DAUSTER & PARTNER**; Kronenstrasse 30, 70174 Stuttgart (DE).

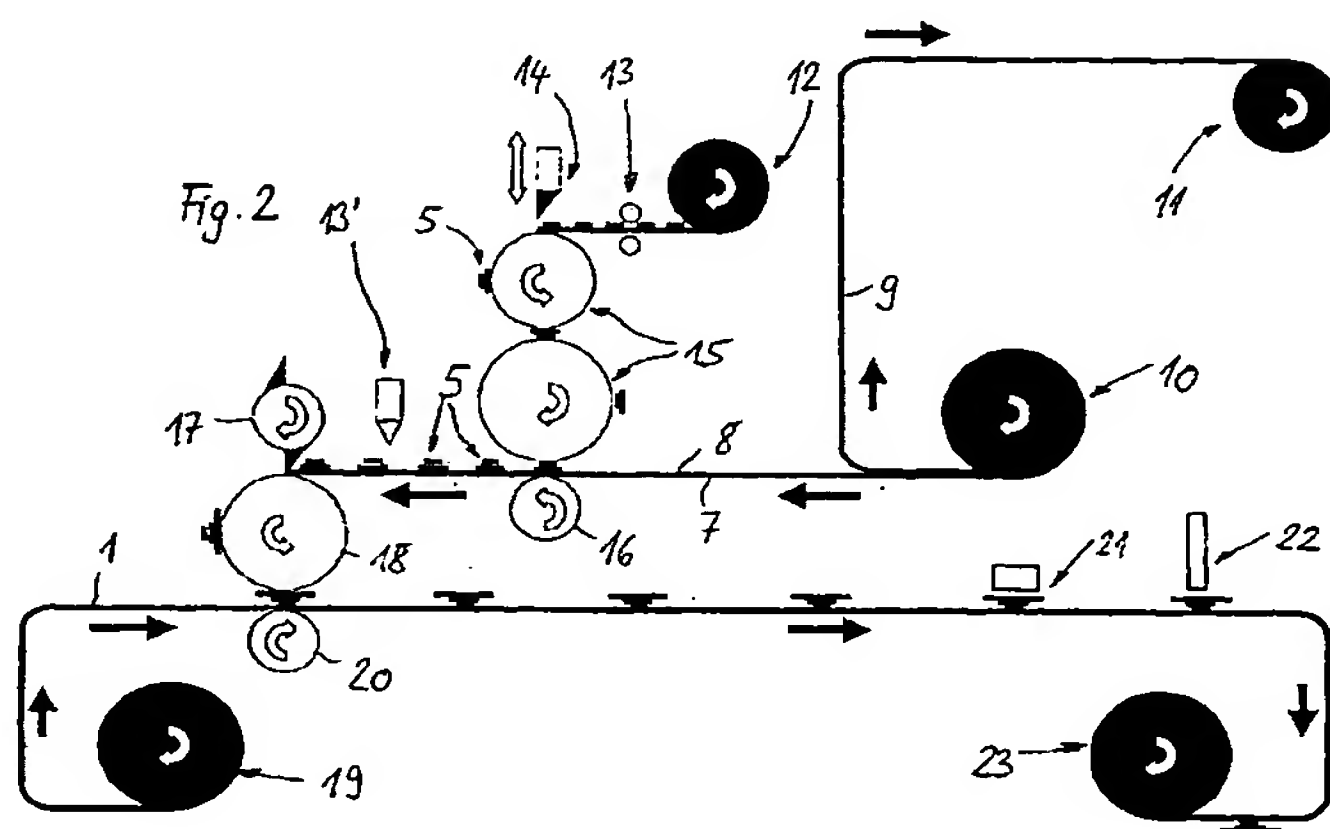
(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: **METHOD AND DEVICE FOR CONTINUOUSLY PRODUCING ELECTRONIC FILM COMPONENTS, AND AN ELECTRONIC FILM COMPONENT**

(54) Bezeichnung: **VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM KONTINUIERLICHEN HERSTELLEN ELEKTRONISCHER FOLIENBAUTEILE SOWIE ELEKTRONISCHES FOLIENBAUTEIL**



(57) Abstract: The invention relates to a method and device for continuously producing electronic film components, during which chip modules (5) are, via their electrical connecting contacts (3), placed on antenna connections (2) of antenna film sections. The invention provides that: the chip modules (5), via their rear side facing away from the connecting contacts (3), are placed on adhesive film sections (7, 8) whose base area is significantly larger than a base area of each chip module; the electric connecting contacts of the chip modules are electrically contacted by antenna connections, and; the adhesive film sections (7, 8) are flatly joined to the antenna film sections in such a manner that the chip modules are fixed in their position relative to the antenna connections. The invention is for use in flexible transponder labels.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2005/076206 A1



EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

*Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.*

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

**(57) Zusammenfassung:** Ein Verfahren und eine Vorrichtung zum kontinuierlichen Herstellen elektronischer Folienbauteile, bei denen Chipmodule (5) mit ihren elektrischen Anschlusskontakten (3) auf Antennenanschlüsse (2) von Antennenfolienabschnitten aufgebracht werden, ist bekannt. Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass die Chipmodule (5) mit ihrer den Anschlusskontakten (3) abgewandten Rückseite auf Haftfolienabschnitte aufgebracht werden (7, 8), deren Grundfläche jeweils wesentlich größer ist als eine Grundfläche jedes Chipmoduls, dass die elektrischen Anschlusskontakte der Chipmodule mit den Antennenanschlüssen elektrisch kontaktiert werden, und dass die Haftfolienabschnitte derart flächig mit den Antennenfolienabschnitten verbunden werden, dass die Chipmodule relativ zu den Antennenanschlüssen lagefixiert werden. Einsatz für flexible Transponderetiketten.